

資工系團隊榮獲「2025」台灣創新技術博覽會

金獎殊榮

我校資訊工程學系，由韓欽銓老師率領之研究團隊，以專利技術「粉末冶金成型機之模具損壞預警系統與模具損壞預警方法」參加「2025 台灣創新技術博覽會」（簡稱創博會），在眾多創新研發成果中脫穎而出，榮獲大會金獎，展現本校在智慧製造領域的研究實力與創新能量。

本屆創博會於 10 月 16 日至 18 日在台北世貿一館盛大展出，由 11 個政府部會聯合主辦，並由 中華民國對外貿易發展協會及 工業技術研究院共同執行，主題訂為「AI 跨域創新 智慧驅動未來」。展會共吸引 19 個國家、超過 400 家國內外企業及學研機構參與，展出項目突破千項。

韓老師團隊所開發的預警系統，專注於粉末冶金成型機模具之異常偵測與損壞預警，結合感測技術與演算法模型，可提前監控模具耗損情況，有效降低生產設備停機風險並提升製造效率。在創博會「發明競賽區」中脫穎而出，與來自全台各大專院校與企業的超過 500 件參賽作品同場角逐。

在 10 月 18 日頒獎典禮當天，本校學生 葉易鋁 同學代表團隊出席受獎，展現師生共同努力、研發成果落地的精彩瞬間。此次榮獲金獎，不僅彰顯本校在智慧製造、人工智慧應用及產學整合上的突顯成果，也為學校未來在創新技術領域開拓更廣場域奠定堅實基礎。

未來，韓老師帶領的團隊將持續深化技術開發與應用推廣，積極參與產業合作與實務驗證，引領智慧製造升級、推動台灣製造業邁向精準監控與預測維護的新里程。

參展錦集



參展攤位展示



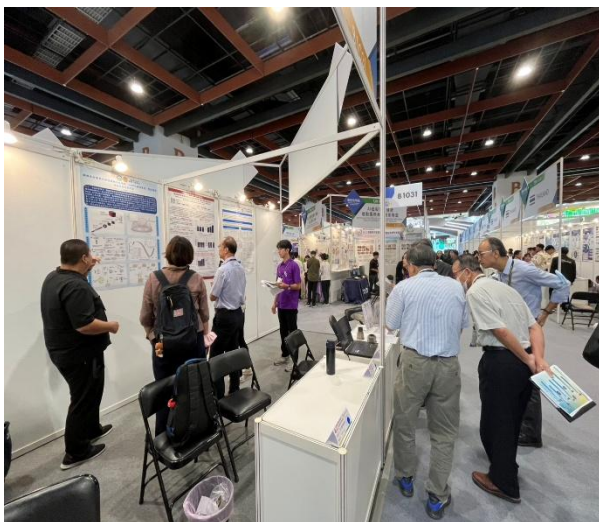
參展作品獲獎紀錄



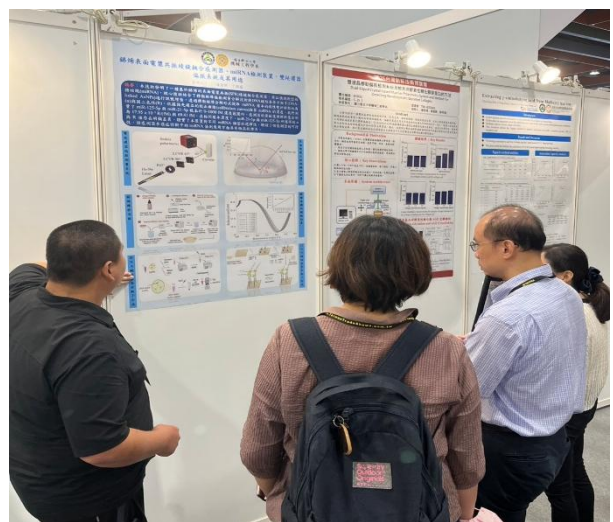
研究成果現場解說



參展作品獎項展示



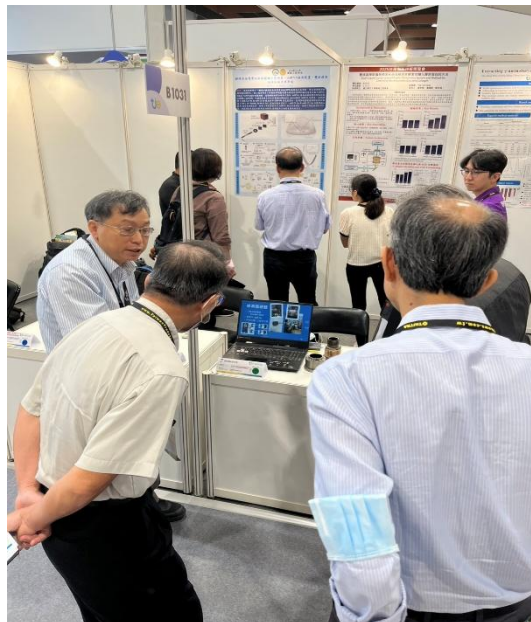
展覽現場交流情形



研究成果介紹與交流



研究技術現場解説



研發成果現場交流